

無電解めっきのデメリットは、電解で / 半導体部品に

# 電解Ni・Pd・Auめっき

～技術確立と事業化のご案内～



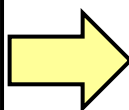
## 1、技術要旨

Pdめっきについては下地の拡散防止バリア層として性能が非常によく使用されています。電解Auめっきを多く取り扱う弊社では、ニーズにお応えすべく電解Ni/Pd/Auめっき工法を確立いたしました。

## 2、無電解めっきのデメリットは、電解で

### （無電解めっき）

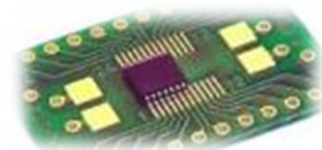
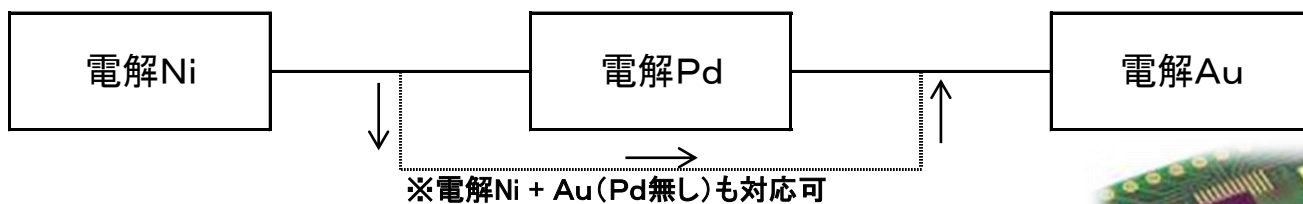
- ・膜厚の厚付けが出来ない。
- ・液更新による材料ロスが発生する。
- ・処理時間が長く生産性が悪い。
- ・下地の無電解Niの仕様に制限がある。



### （電解めっき）

- ・膜厚に制限なく処理が可能。
- ・材料ロスが少なくランニングコストが安い。
- ・処理時間が短く、生産性向上と加工費低減が可能。
- ・下地に制限なくNi以外も含め選択が可能。

## 3、めっき仕様



## 4、特長と膜厚

電解Ni	電解Pd	電解Au
膜厚: 制限なし * 非磁性目的で下地Cuめっきでも対応可能	膜厚: 要求仕様による対応可能 * 耐熱による下地Ni層の拡散防止(バリア層)	膜厚: 制限なし WB性・はんだ接合性が良好 ※半導体部品に適したAuめっきです

## 5、対象物

製品事例	対象物の材質	PR
各種基板 / ガラスハーメ品 接点部品 / 複合部品 等	Cu系 / Fe系 / SUS系 アルミ / Mo / W / Ti メタライズ品(スパッタ・ロウ付け品等)	弊社固有のめっき技術で、アルミ・SUS・難素材(Mo・W等)を下地めっきすることが可能です

(製品イメージ)



～不可能への挑戦～

株式会社 友電舎

大阪市此花区常吉2-4-8

tel 06-6465-1663

e-mail : info@ydn.co.jp

URL : http://www.ydn.co.jp

